

**关键指标**

- 频率: 2~5GHz
- 增益: 10dB
- 噪声系数: 3.3 dB
- 1dB 压缩点输出功率: 10dBm
- 电压/电流: +5V/19mA
- 芯片尺寸: 1.2mm×0.9mm×0.1mm

**产品简介**

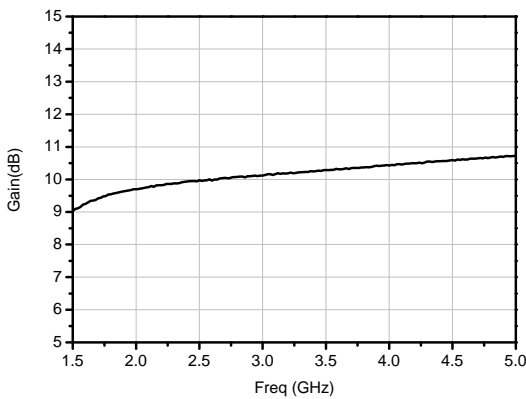
HG113FW-2 是一款 2~5GHz 低噪声放大器芯片, 增益为 10dB, 噪声系数 3.3dB, 1dB 压缩点输出功率为 10dBm。

**电性能 (TA=25°C, Vdd=+5V)**

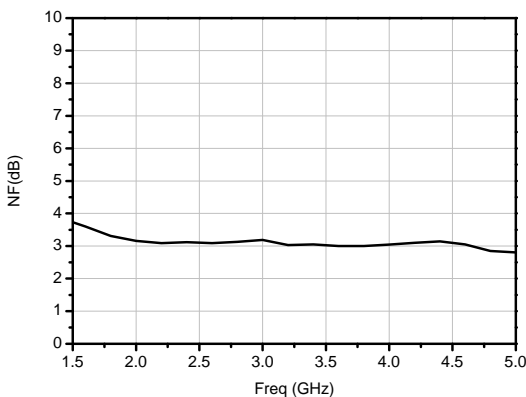
指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	2~5		
增益(dB)	—	10	—
增益平坦度(dB)	—	±0.5	—
输入驻波	—	1.2	—
输出驻波	—	1.3	—
噪声系数(dB)	—	3.3	—
1dB 压缩点输出功率(dBm)	—	10	—
静态电流 (mA)	—	19	—

**典型测试曲线**

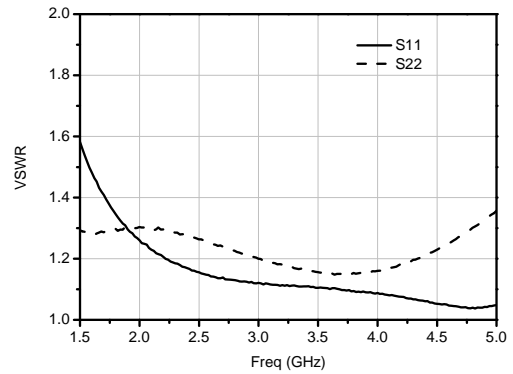
增益



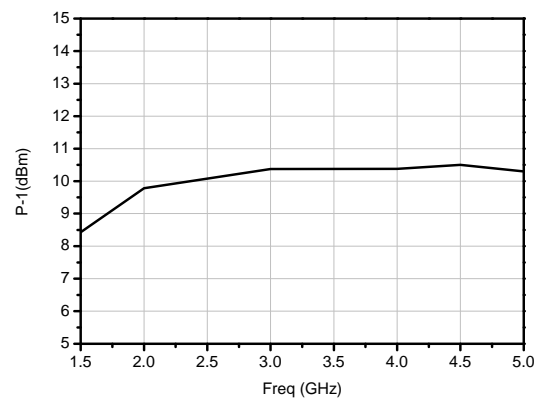
噪声系数



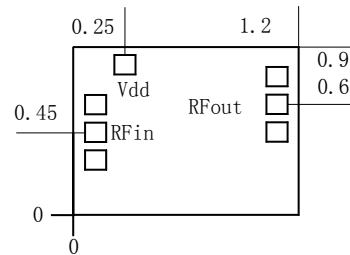
驻波



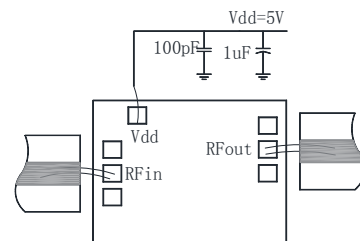
1dB 压缩点输出功率



**外形和端口尺寸 (mm)**



**推荐装配图**



**绝对额定最大值**

工作电压	+7V
最大输入功率	+15dBm
工作温度	-55°C ~ 125°C
存储温度	-65°C ~ 150°C

### 注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 300℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用  $\Phi 25\mu\text{m}$  双金丝键合，建议金丝长度 250~400 $\mu\text{m}$ ；
5. 芯片微波端有隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。